

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2022-012

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于公司拟新增银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、综合授信基本情况概述

为满足公司发展的资金需要，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增银行综合授信，具体如下：

银行名称	授信金额	授信期限	抵押/担保方式
江苏银行股份有限公司吴江支行	不超过 5,000 万元	1 年	无
上海银行股份有限公司苏州分行	不超过 5,000 万元	1 年	无
浙商银行股份有限公司吴江支行	不超过 8,000 万元	1 年	无

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现、融资性保函、免保证金外汇衍生品等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

授信期限内，授信额度循环使用。在有效期内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署有关与各家银

行发生业务往来的法律文件，除相关法律法规规定的必须另行提请董事会审议的情形外，董事会不再另行召开会议审议。

二、审议和表决情况

2022年3月14日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议和表决通过了《关于公司拟新增银行综合授信的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、公司申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2022年3月14日